特集◆金型・部品製造における最新のプロセスモニタリング技術と適用効果

事例 部品成形

# 光ファイバセンサによる 温度・ひずみ計測システムの金型への適用

(株)富士テクニカルリサーチ 高原 忠良\*

ハード・ソフトの能力向上により、解析を活用した エンジニアリング (CAE) は身近なものとなってい る。これに伴い、CAE の妥当性の吟味がより重要と なっている。光ファイバをセンサとして温度・ひずみ を計測する「FBI-Gauge<sup>11</sup>」を活用することで、これ

\*Tadayoshi Takahara:名古屋テクニカルセンター 〒460-0008 名古屋市中区栄 5-28-19 TEL (052) 269-1321



図1 光ファイバの特徴と取付け方

まで不可能であった型内の温度・ひずみの広範囲での 分布計測が可能となった。1 秒間に 250 回まで計測で きるため、加工中の動的な変化も捕捉可能である。 CAE の検証とともに、型内挙動のリアルタイムモニ タリングのツールとしても活用が拡大している。本稿 では、計測システムの特徴と金型への適用事例を紹介 する。

# 光ファイバ計測システム FBI-Gauge の特徴と原理

図1に、ファイバセンサとひずみゲージとの寸法 比較、システムの特徴、ファイバの取付け方法を示す。 ファイバ径は155µmであり、型内やごく局部への 取付けも可能である。計測ピッチは最小0.65mmご とに、また、最長50mにわたっての計測も可能であ る。光ファイバがセンサとして機能する計測方法であ り、光ファイバを型内に設置することで型内の変化を リアルタイムに計測可能となる。外部からの観察手法 である、画像相関法によるひずみ計測や放射温度計に よる温度計測では得られない、型内挙動の観察が可能



となることも大きな特徴である。

図2に計測原理を示す。ファイバを構成する石英 ガラスの密度や組成の揺らぎなどにより、ファイバの 局所ごとでレイリー後方散乱が生じる。各散乱は部位 ごとに特有の周波数分布を呈している。いわば、ファ イバごとの固有指紋情報である。OFDR (Optical Frequency Domain Reflectometry) 方式で入射光の波 長を連続的に変化させることでファイバの位置情報を 取得する。すなわち、波長可変レーザー光源からの直 接光と光ファイバ各部位からの反射光とにより干渉光 が生じる。その周期から得られる光路差によりファイ バ位置(距離)を特定できる。

また、光ファイバに外力がかかった場合、レイリー 散乱光のピーク周波数が微小に変化する。この変化量 (周波数シフト量)を温度あるいはひずみに換算する という計測原理である。

# 射出成形型挙動の詳細観察への 適用と CAE を活用した考察<sup>20</sup>

射出成形金型の可動型・固定型にそれぞれ1本の 光ファイバを取り付け、成形運転中の温度とひずみを 連続的に計測した事例を紹介する。図3に金型の概 要と光ファイバの取付け状況を示す。可動型・固定型 それぞれに R1mm の溝加工を施し、その溝に、ひ ずみ用・温度用それぞれの取付け方法でファイバを配 置してある。表に実験条件と使用機器類を示す。

#### 1. Step.1:型内現象の温度・ひずみの同時計測

図4は、型温度の分布コンター図と一成形サイク ル中の経時変化グラフである。グラフから、キャビテ ィ外に相当する位置のT1ではほとんど型温度が変化 しないこと、流動端末に相当するT3では、ゲート直 下に相当するT2を基準とすると、約2.5秒遅れて型 温度が上昇し始めることが確認できる。

図5は、型ひずみの分布コンター図と一成形サイ クル中の経時変化グラフである。コンター図から、金 型の長辺方向では引張りひずみ、短辺方向では圧縮ひ ずみという特徴的なひずみの分布が確認できる。グラ フからは、型締め昇圧完了に相当する成形開始約2

表 実験条件と使用機器類

使用樹脂	㈱プライムポリマー製 ポリプロピレン J-650 HP
成形機	東芝機械㈱製 射出成形機 EC 220 N-16 A
成形条件	樹脂温度:210℃ 射出速度:30 mm/s 保圧条件:70 MPa、5 sec 冷却時間:30 sec 雰囲気温度:3℃ 金型初期温度:40℃ サイクルタイム:65 sec/サイクル
使用機器	㈱富士テクニカルリサーチ製 光ファイバセンシングシステム FBI-Gauge A-Type
光ファイバ	長さ 3m 2本(可動側1本、固定側1本)



図3 金型の概要と光ファイバの取付け状況















図6 1成形サイクル中の型温度と型ひずみの変化

秒後にひずみが安定した後、射出開始から約2秒後 に表記した4点すべてで100~200μStrain程度の圧 縮ひずみが生じていることがわかる。ピーク以降は 徐々に圧縮ひずみが低減する。

図6は、型温度と型ひずみを時間軸を揃えて表記 したグラフである。圧縮ひずみが生じるタイミングは、 全点で流動端末であるT3の型温度上昇のタイミング と一致している。

#### 2. Step.2: 計測した現象の考察

計測した特異な現象を CAE も活用して考察した。 まず、型締めとともに型ひずみに分布が生じる原因を 検討した。型締めとともにひずみが生じていることか ら、型締め力による金型の弾性たわみによるひずみと 推察し、型締め力に相当する 2,000 kN を負荷した型 剛性解析を「Abaqus」で実施した。図7に計測結果 と CAE 結果の比較を示す。ほぼ同様のひずみ分布を 示しており、型締めによる型変形のためであることが 確認できた。

次に、キャビティ端末の温度が上昇を開始するタイ

### 特集◆金型・部品製造における最新のプロセスモニタリング技術と適用効果



図7 型剛性解析による型締め時のひずみ分布の検討



## 図8 流動解析での型の各部位の圧力変化と その挙動の型剛性解析との連成

ミングで、型全体に圧縮ひずみが生じる現象を考察し た。端末まで樹脂が流動したタイミングで生じている 状況から、流入した樹脂の影響と考えられる。まず、 東レエンジニアリング㈱製の「3D TIMON」による 流動解析で型内各部位での樹脂圧力の経時変化を求め た。次に、この時間変化を型の各部位の入力荷重とし、 型剛性を解析した。図8は、流動解析による樹脂圧 力の経時変化と、その結果の型剛性解析へのマッピン グである。図9にCAEと計測結果の比較を示す。 変化挙動が合致しており、ひずみ量もおおむね一致し ていることから、推察どおりの型変形が生じていると 考えられる。



対策前 対策後 射出→保圧→冷却 型開き 型締め 型締め 射出→保圧→冷却 型開き 100 100 µStrain) (μStrain) 0 100 型ひずみ r\$ -200 -200 **S**2 S1 配い S1 **S**2 -300 -300 S4 S3 **S**3 S4 -400 -400 0 10 20 30 40 50 60 0 10 20 30 40 50 60 時間 (sec) 時間 (sec) ブロック追加により 型締め時の金型変形抑止 射出時ひずみも低減

図 10 ブロック追加による型変形対策の効果



図 11 ダイカスト金型における温度の分布と 経時変化

# 3. Step.3:型変形対策案のデジタル検討

型締めによる型たわみ挙動から、型上下のポケット 形状の問題と推察し、上下それぞれにブロックを設定 した。実際には市販のモールドベースを活用しており、 エジェクタプレートの前後運動の関係上、このブロッ クの設定は大規模な型改造となるためにデジタル的に 検討した。

図 10 はブロックの有無での差異である。ブロック の追加により、型締め時のひずみ分布がほぼゼロとな り、さらに樹脂充填時の圧縮ひずみもおおよそ 1/3 程度に低減しており、バリ発生の抑止効果もあるもの と推定された。

以上をまとめる。光ファイバをセンサとした計測シ ステムで、温度・ひずみを同時かつ広範囲の分布とし



図 12 プレス金型のブランクホルダへの光ファイバ 設置状況

て連続的に計測することが可能となった。光ファイバ を型内に設置することで、型内の詳細挙動を観察した。 その結果、型締めに伴うひずみ分布、樹脂充填による 金型への圧縮ひずみの発生といった挙動を捉えること ができた。さらに、CAE を組み合わせることで、現 象検討の深掘りや型変形対策も可能となった。

## 適用事例

#### 1. ダイカスト金型

ダイカストにおける重要な課題はバリの抑制である。 バリの要因の一つである型温度分布とその成形ごとの 変化の把握が重要となるが、従来の手法では計測が困 難であった。本計測システムによる計測結果例を図11 に示す。入れ子部における温度分布から高温部位を把



図 13 ひずみの分布と経時変化のパネル有無での比較

握した。その部位での成形サイクルごとの急激な温度 変化や入れ子への蓄熱による温度上昇が確認できる。

2. プレス金型

これまではプレス金型の広範囲でのひずみの動的変 化の計測は困難であった。ここでは、プレス金型のブ ランクホルダ部のひずみ挙動の計測例を紹介する。図 12 はブランクホルダへの光ファイバの取付け状況、 図 13 はプレス用鉄パネルの有無によるひずみ計測結 果の比較である。同図(a)、(b)上部のコンター図は、 横軸が光ファイバ長手方向のひずみ分布を、縦軸が下 から上に向かって、プレス成形の経過を示している。

#### ☆

ここ数年で活用が急拡大している光ファイバ計測シ ステムの特徴と原理を説明するとともに、金型に適用 した事例を紹介した。センサとしては光ファイバを使 用するが、その直径はわずか155µmであり、かつ 光ファイバの長さ全域で計測が可能であり、型内の広 範囲の計測が可能である。さらに光ファイバの適用方 法を創出することで、これまで把握できていない型の 挙動の把握も可能と考えられ、適用の拡大が期待され る。また、連続的な計測も可能であり、生産中のモニ タリング装置としても期待される。

## 参考文献

- 富士テクニカルリサーチ ウェブサイト: https://ftr.co.jp/solution/hardware/fbi\_gauge/
- 2) 高原、名取、大友、高橋、今井:計測・CAEを活用した原理原則回帰の成形加工、成形加工 '19(2019)、p.11

